

KEPSTAN®

6004

KEPSTAN® PEKK树脂是以聚醚酮酮（PEKK）为分子主链的高度稳定的高性能热塑性塑料。KEPSTAN® PEKK 是聚醚酮系列中的一款独特产品，呈独特的结构特点，具有非凡的结晶度控制能力。其特点包括低醚/酮比率，以及由对苯二酰和间苯二酰基组成的共聚物结构。

6000系列 属于 KEPSTAN® 系列中的假无定形产品，熔点最低，结晶速度最慢，Tg接近于160°C。由于具有这些特性，其加工温度较低（低至320-330°C），加工后，根据不同的加工技术和冷却条件，产品呈玻璃态或半结晶态结构。

KEPSTAN® 6000系列 包括一种中等流动性牌号KEPSTAN® 6002和一种高流动性牌号KEPSTAN® 6003，两种产品均为非填充型聚醚酮酮树脂，可满足广泛的加工技术要求，包括挤出、压延、热成型、注塑、纤维浸渍、滚塑、粉末涂覆、粘结和焊接。

KEPSTAN® PEKK 树脂

有料和粉料两种形式供货，粉料包含多种不同粒径。标准包装规格有20公斤粒料箱装和10公斤粉料箱装。

性能	价值	单位	测试标准
流变性能			
熔体体积流动速度	24	cm³/10min	ISO 1133
温度	380	°C	-
	716	°F	-
载荷	1	kg	-
	2.2	lb	-
机械性能			
拉伸模量	2900	MPa	ISO 527-1/-2
	421000	psi	
简支梁冲击强度, +23°C	无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度, -30°C	无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	5	kJ/m²	ISO 179/1eA
	2.38	ftlb/in²	
简支梁缺口冲击强度, -30°C	4.5	kJ/m²	ISO 179/1eA
	2.14	ftlb/in²	
热性能			
热变形温度, 1.80 MPa	139	°C	ISO 75-1/-2
	282	°F	
氧指数	38	%	ISO 4589-1/-2
电性能			
相对介电常数, 1MHz	2.5	-	IEC 60250
其它性能			
密度	1270	kg/m³	ISO 1183
	1.27	g/cm³	

干燥温度和时间：120°C，6至8小时

加工温度：320 – 360°C

温度设置—注塑：后段300°C / 中段：315°C / 前段320°C / 喷嘴330°C

成型温度（在任何情况下需低于Tg）：80 - 120°C

温度设置—挤出：功能区1/2/3/4：290°C/ 320°C/ 330°C/ 320°C 口模：320°C

KEPSTAN®

6004

加工方法

注塑, 异型材挤出成型, 涂覆

供货形式

粒料, 粉料

地区供应

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲